

テーマ情報 Theme information					Fタームデータ F-term data				
テーマ コード Theme code	解析停止 Deactivated	解析 タイプ Type	テーマ名 Theme name	FIカバー範囲 FI coverage	改正情報(メンテ内容等) Maintenance information	Fターム の有無 F-term existence	解析年範囲 Assigned period		再解析中 Under reassignm ent
							開始年 Start	終了年 End	
4M104		F	半導体の電極	H01L21/28-21/288@Z;21/44-21/445;29/40-29/64		○			
4M105	○		ワイヤレスボンディング	(H01L21/60,311-21/60,311Z)	5F044に統合(H10)	○		1998	
4M106		F	半導体等の試験・測定	H01L21/64-21/66@Z		○			
4M108		FI	LOCOS	H01L21/94-21/95	FI化(R2)	○			
4M109		F	半導体又は固体装置の封緘, 被覆構造と材料	H01L23/28-23/30@Z		○			
4M112		F	圧力センサ	H01L29/84-29/84@Z		○			
4M113		F	超電導デバイスとその製造方法	H10N60/00-60/12@Z;60/35;60/82-69/00	4M115と統合(H15)	○			
4M114		F	超電導用冷却・容器・薄膜	H10N60/20-60/30;60/355-60/81		○			
4M115	○	FI	超電導一般	(H01L39/06-39/12@Z;39/18)	4M113へ統合(H15)				
4M116	○		ボンディング関連技術	(H01L21/60;21/60,321-21/60,321Z)	5F044に統合(H10)			1998	
4M118		F	固体撮像素子	H01L27/14-27/148@Z;29/76,301-29/76,301@Z;H10K39/32-39/34		○			
4M119		F	MRAM・スピンメモリ技術	H10B61/00	旧5F083テーマ分割、リスト再作成(H17)	○			